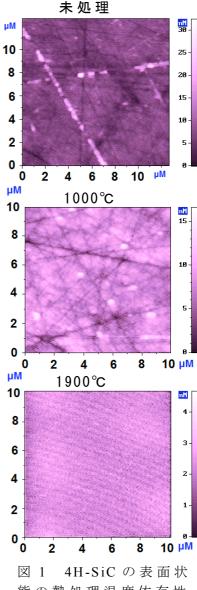
ワイドギャップ半導体 SiC のキャリア緩和のフェムト秒分光 による研究

(関学大・理工)○玉井尚登,水本幸太郎,北田知己,王 莉,鳥見 松田一宏、金子忠昭

【序論】SiC はワイドバンドギャップの間接遷移型のバンド構造を持つ IV-IV 族化合物半導体である。常圧では液相が存在せず、およそ 2000~ 2200℃以上の高温で昇華するという熱的安定性に加えて、化学的・機械的安 定性を有する材料である。Siよりバンドギャップ、絶縁破壊電圧、耐熱性 などの大きい半導体で半導体素子を作ろうという試みがなされている現状 において、SiCは高絶縁破壊電界、高飽和電子速度、高熱伝導度などの優れ

た物性を持ち、p型、n型の価電子制御が容易な 半導体であるので、近年多くの注目を浴びる様 になった。特に厳しい環境において動作可能な 高耐圧, 高耐熱, 高速用パワーデバイスへの応 用が期待されている。結晶学的には、SiC は同 一の組成で c 軸方向に対して多様な積層構造を とる結晶多形(ポリタイプ)を示し、約200種 類が確認されている。現実的には、6H-SiC と 3C-SiC が主流であるが、現在最もデバイス応用 に適していると考えられている 4H-SiC も重要 である。しかしながら、SiC の光物性、特に励 起状態ダイナミクスに関しては報告例が極めて 少ない。本研究では、幾つかの温度(高温)で 4H-SiC をアニールして熱処理効果によって表 面状態だけでなく光物性がどの様に変化するの か,フェムト秒過渡吸収分光によって解析した。 さらに、4H-SiC だけでなく 6H-SiC と 3C-SiC に関してもレーザー分光による解析を行い 4H-SiCと比較したので報告する。

【実験】SiC 結晶の表面形状制御方法として高 温真空アニール法を用いた。SiC を高温にする と昇華が始まり、Siの昇華量の方が多いため表 面に炭素が残り、炭化した状態となる。従って 表面が荒れてしまうだけでなく黒く変色する。 この様な表面荒れを防ぐために、Si雰囲気を用 いて単結晶アニールを試みた。4H-SiCのアニー ル温度は、1000℃から 1900℃まで変化させた。 AFM 測定により、各々の試料の表面構造の熱処 理依存性を解析した。また 6H-SiC と 3C-SiC に 関しては、未処理のものを用いた。フェムト秒 過渡吸収測定は、増幅したフェムト秒



態の熱処理温度依存性

Ti:Sapphire レーザーの第三高調波(266nm) をポンプ光とし、フェムト秒白色光をプロー ブ光として過渡吸収スペクトルを測定した。

【結果・考察】SiC はダイヤモンドに次ぐ硬度を持っており、これまでダイヤモンド砥粒きを用いて表面を研磨する方法が用いられてうた。この為、表面に研磨傷が残ってしまうので、エピタキシャル結晶成長や品質向上の為には研磨ダメージを除去しなければならない。図1に特殊な炉を用いて種々の温度で4H-SiCをSi雰囲気下でアニールした場合のAFMによる表面構造の観察結果を示す。1000℃程度までは表面に大きな変化はなく

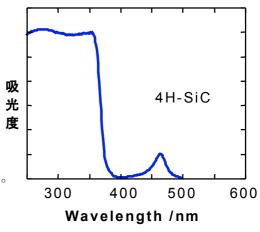


図 2 4H-SiC の吸収スペクトル

研磨傷が残っているのがわかる。1400 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 付近から変化が起こりはじめ,1900 $^{\circ}$ では表面に細かいステップが形成されているのがわかる。Si 雰囲気下では,炭化が全く起こらず表面に余分な C 原子が残っていないので,SiC(s) + Si (gas) \rightarrow $Si_2C(gas)$

の反応により SiC 基板から Si と C が 1:1 で離脱した為と考えられる。

図 2 に 4H-SiC の吸収スペクトルを示す。4H-SiC のバンドギャップ 3.3eV に対応したスペクトルが観測されると共に 470nm にピークを持つバンドが

観測される。このバンドは、積層内に存 在する窒素が原因であると言われている。 このバンドのアニール温度依存性を調べ たが、1900℃においても熱処理していな い 4H-SiC の吸収と殆どかわらず、積層 内の窒素は高温でも離脱しないことがわ かった。一方、4H-SiC の発光は極めて弱 く、 単一光子法を用いても検出すること が出来なかった。図3に4H-SiCの266nm 励起による過渡吸収スペクトルを示す。 時間の初期に非常にブロードなブリーチ ングが観測された。その後、緩和時間が 長くシャープなブリーチングが吸収に対 応する 470nm 付近で観測された。この窒 素に由来するブリーチングダイナミクス は、2 つの指数関数の和で解析でき、長 い寿命成分は 1.6~1.7ns の寿命を持って いる。この寿命成分は、熱処理温度に殆 ど依存しない。一方、短寿命成分は未 処理のものが 40ps, 高温で熱処理した ものが 100ps 以上であり、短寿命成分

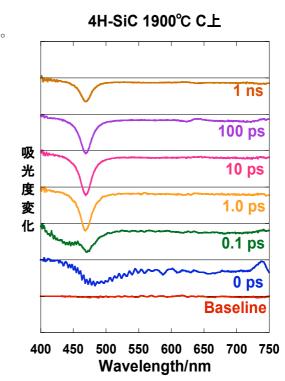


図3 4H-SiC の過渡吸収スペクトル

の振幅も高温になるにつれ小さくなる。この結果から、熱処理により表面構造を変えると、窒素以外の不純物準位などの欠陥がより少なくなったものと考えられる。他の波長領域では、100fs 以内の極めて早い緩和が観測されており、6H-SiC や 3C-SiC の過渡吸収ダイナミクスの結果も合わせて SiC のキャリア緩和の詳細を報告する。